

Нужен ли Press Fit моей плате?

Чек-лист для конструктора



Отметьте утверждения, которые относятся к вашему проекту. Если вы ответили утвердительно два и более раз — технология Press Fit рекомендована.

1. Тепловые признаки

- ☐ Плата имеет 8 и более слоёв.
- ☐ Присутствуют массивные полигоны земли и питания (сплошные слои меди).
- ☐ Толщина платы превышает 2,5 мм.
- ☐ Уже сталкивались с непропаем или «холодной пайкой» при монтаже разъёмов.

2. Механические признаки

- ☐ Изделие будет эксплуатироваться в условиях вибраций и ударных нагрузок.
- ☐ Эксплуатация предполагает перепады температур (термоциклирование).
- ☐ Разъём имеет большое количество выводов (свыше 50 контактов).
- ☐ Допустимый процент брака при монтаже — минимальный или нулевой.



Нужен ли Press Fit моей плате?

Чек-лист для конструктора



3. Производственно-экономические признаки

- ☐ Планируется серийный выпуск.
- ☐ Требуется сократить время монтажа и исключить расходные материалы (припой, флюс, отмывку).
- ☐ Необходимо обеспечить документированное подтверждение качества каждого соединения.

Результат

- 0–1 «да»: Press Fit, вероятно, не требуется. Достаточно традиционной пайки.
- 2–4 «да»: Press Fit рекомендован. Переход на запрессовку повысит надёжность и технологичность.
- 5 и более «да»: Press Fit — оптимальное решение для вашей платы. Рекомендуем начать с консультации и расчёта допусков.

Запросить консультацию

Пришлите файлы платы и спецификацию компонентов на наш электронный адрес info@acont.ru. Мы проведём анализ вашего проекта, сообщим о возможности применения технологии Press Fit и, при необходимости, дадим рекомендации по доработке конструкторской документации.

[Задать вопрос](#)